

中国半导体硅片行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202606/797626.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

一、量增价跌，半导体硅片行业处于周期底部反转窗口期

半导体硅片是半导体产业链上游的核心基石环节，占芯片制造总成本的30%-40%，具备技术壁垒高、资本开支重、行业周期性强三大典型特征。

当前，全球 AI 算力与硅光技术的快速迭代，正持续拉动半导体材料需求的结构性复苏，而硅片作为价值量最高、技术壁垒最深的核心材料，正迎来周期底部反转与国产替代加速的双重驱动窗口。

2025 年全球硅片出货量同比增长5.8%，达到 129.73 亿平方英寸（MSI）；同期硅片销售额则下滑 1.2%，至 114 亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、半导体硅片整体市场结构显著分化，8英寸产能收缩、12英寸成出货主流

半导体硅片按尺寸可划分为 12 英寸、8 英寸、6 英寸及以下三大类别，整体市场呈现显著结构性分化。

受人工智能、数据中心建设热潮拉动，适配先进逻辑芯片、高带宽内存（HBM）的12英寸硅片需求持续高景气，是各大硅片企业营收的核心支柱。目前 12 英寸硅片已成为全球市场出货主流，出货占比达 78.8%。

8英寸硅片主要应用于成熟制程的功率芯片、模拟芯片领域，受下游客户库存调整影响，行业复苏节奏偏缓，产能已步入收缩周期。台积电、三星等行业龙头自 2025 年起相继启动减产计划：台积电计划逐步缩减 8 英寸产能，预计 2027 年实现部分厂区全面停产，集中资源布局高附加值先进制程；三星同步加大 8 英寸产能削减力度。当前 8 英寸硅片全球出货占比为 17%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、半导体硅片制造呈现寡头垄断状态，日本信越、SUMCO主导地位稳固

目前全球半导体硅片市场以日本、台湾和韩国厂商为主，市场高度集中，信越、SUMCO、环球晶圆、世创、SK Siltron海外五大巨头垄断全球95%份额，其中日本信越、SUMCO合计占据全球半壁江山，主导 12 英寸先进制程。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、半导体硅片国产厂商加速产能扩张步伐，盈利有望修复

面对12英寸硅片广阔的市场前景，国产厂商纷纷加大投资力度，加速产能扩张步伐。预计到2030年，全球12英寸硅片的市场规模将突破200亿美元，而中国市场的占比将超过40%。

国产12英寸硅片扩产情况 厂商 扩产情况 沪硅产业 沪硅产业持续推进多个产品升级及扩产

项目，包括上海新昇二期30万片/月300mm硅片产能建设项目、300mm高端硅基材料研发中试项目以及集成电路用300mm硅片产能升级项目（三期）等。其中位于太原和上海两地的300mm硅片产能升级项目正在加紧建设中，项目总投资额达132亿元（太原项目约91亿元，上海项目约41亿元）。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。西安奕材西安奕材2025年下半年第二工厂持续扩产，截至2025年12月已具备20万片/月产能。2026年随着第二工厂达产，固定成本将被有效摊薄，加之市场复苏预期，抛光片产品毛利率有望修复。公司HBM用抛光片产品正处于客户验证和联合研发阶段，第二工厂计划在2026年底达到设计产能50万片/月。立昂微立昂微当前的扩产项目主要包括：投资22.62亿元的年产180万片12英寸重掺衬底硅片项目、投资23.02亿元的年产180万片12英寸半导体硅外延片项目、投资12.30亿元的年产96万片12英寸轻掺硅外延片项目，正有序推进中。上海合晶上海合晶正在加速建设郑州合晶扩产项目。公司当前12英寸外延片产能为4万片/月，主要应用于功率器件领域；预计郑州二期今年年底通线，2026年底完成6万片/月12英寸外延片产能建设，主要应用于CIS模拟芯片领域，目前国内目标客户已锁定并完成送样阶段。此外，公司于2026年3月发布定增计划，拟募资不超过9亿元，重点投向12英寸半导体大硅片产业化项目，进一步强化大尺寸硅片产能布局，实现产品矩阵的升级。中环领先其12英寸轻掺硅片已通过台积电认证并批量供应，且公司当前12英寸硅片产能70万片/月，2026年规划扩至100万片/月，产品“可用于AI芯片晶圆制造”。

资料来源：观研天下整理

国内半导体硅片行业处于扩产阵痛期+国产替代攻坚期，短期以规模换份额、份额换营收，但折旧、价格、良率、费用四重压力导致增收不增利；长期看，产能利用率提升、良率改善、产品高端化后，盈利有望修复。

2026年Q1国产硅片厂商业绩 厂商 营业收入 (亿元) 同比变化 (%) 归母净利润 (亿元) 同比变化 (%) 扣非净利润 (亿元) 同比变化 (%)

TCL 中环	65.50	7.34	-16.47	13.62	-18.00
沪硅产业	10.84	35.22	-4.83	亏损扩大	-5.24
立昂微	9.99	21.81	0.07	扭亏为盈	0.12
西安奕材	7.23	10.57	-1.58	亏损扩大	-1.71
有研硅	3.14	18.04	0.50	-1.24	0.34
上海合晶	2.80	-0.04	0.13	-34.66	0.09
神工股份	1.12	6.22	0.25	-10.96	0.24
					-9.42

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

国产硅片厂商差异化布局情况 厂商 差异化布局情况

TCL 中环 公司坚持“国内领先，全球追赶”战略，依托半导体硅片出货量国内领先的规模优势，通过精益制造和供应链优化实现极致成本控制，硅片工费同比下降超40%。技术研发聚焦大尺寸和高效能产品，累计授权知识产权4763项，强化技术壁垒，同时依托半导体材料领域的技术积累，实现多业务协同发展，提升抗周期能力。神工股份 神工股份通过一体化优势在细分赛道突围。公司深耕刻蚀用硅材料细分领域，大直径硅材料产品覆盖14-22英寸全规格，在全球细分市场处于优势地位。核心战略是构建“材料+零部件”一体化制造体系，从大直径硅材料到硅零部件的全流程管

控，为国内等离子刻蚀设备厂和存储芯片厂提供定制化解决方案。有研硅依托国家企业技术中心、集成电路关键材料国家工程研究中心等平台优势，形成覆盖半导体硅抛光片、刻蚀设备用材料、区熔硅单晶等多产品体系，兼顾成熟制程与先进制程需求，6-8英寸半导体硅抛光片稳定供货，12英寸产品通过参股公司推进产能爬坡，重点推进“超越摩尔”与“扩展摩尔”相关技术，致力于从“硅材料细分领域”向“半导体核心材料与部件综合供应商”发展。上海合晶

上海合晶则在差异化的外延片上发力，做强功率器件8英寸的同时发展12英寸，8英寸外延片在电阻率均匀性、表面质量等指标上达到国际先进水平。

资料来源：观研天下整理（zlj）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国半导体硅片行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量

行业相关标准

2021-2025年行业销量

PEST模型分析结论

2025年行业成本结构情况

行业所属行业企业数量分析

2021-2025年行业平均价格走势

行业所属行业资产规模分析

2021-2025年行业毛利率走势

行业所属行业流动资产分析

2021-2025年行业细分市场1市场规模

行业所属行业销售规模分析

2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测

行业所属行业负债规模分析

2021-2025年行业细分市场2市场规模

行业所属行业利润规模分析

2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测

所属行业产值分析

2021-2025年全球行业市场规模

所属行业盈利能力分析

2025年全球行业区域市场规模分布

所属行业偿债能力分析

2021-2025年亚洲行业市场规模

所属行业营运能力分析

2026-2033年亚洲行业市场规模预测

所属行业发展能力分析

2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况

2026-2033年北美行业市场规模预测

企业1主要经济指标分析

2021-2025年欧洲行业市场规模

企业1盈利能力分析

2026-2033年欧洲行业市场规模预测

企业1偿债能力分析

2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模

企业4主要经济指标分析

2026-2033年西北地区行业市场规模预测

- 企业4盈利能力分析
- 2026-2033年行业市场分布预测
- 企业4偿债能力分析
- 2026-2033年行业投资增速预测
- 企业4运营能力分析
- 2026-2033年行业市场规模及增速预测
- 企业4成长能力分析
- 2026-2033年行业产值规模及增速预测
- 企业5营业收入构成情况
- 2026-2033年行业成本走势预测
- 企业5主要经济指标分析
- 2026-2033年行业平均价格走势预测
- 企业5盈利能力分析
- 2026-2033年行业毛利率走势
- 企业5偿债能力分析
- 行业所属生命周期
- 企业5运营能力分析
- 行业SWOT分析
- 企业5成长能力分析
- 行业产业链图
- 企业6营业收入构成情况
-
-
- 图表数量合计
- 130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 半导体硅片 行业基本情况介绍

第一节 半导体硅片 行业发展情况概述

一、半导体硅片 行业相关定义

二、半导体硅片 特点分析

三、半导体硅片 行业供需主体介绍

四、半导体硅片 行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国半导体硅片 行业发展历程

第三节 中国半导体硅片行业经济地位分析

第二章 中国半导体硅片 行业监管分析

第一节 中国半导体硅片 行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国半导体硅片 行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对半导体硅片 行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章 中国半导体硅片 行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济发展现状

第二节 中国对外贸易环境与影响分析

第三节 中国半导体硅片 行业宏观环境分析（PEST模型）

一、PEST模型概述

二、政策环境影响分析

三、经济环境影响分析

四、社会环境影响分析

五、技术环境影响分析

第四节 中国半导体硅片 行业环境分析结论

第四章 全球半导体硅片 行业发展现状分析

第一节 全球半导体硅片	行业发展历程回顾
第二节 全球半导体硅片	行业规模分布
一、2021-2025年全球半导体硅片	行业规模
二、全球半导体硅片	行业市场区域分布
第三节 亚洲半导体硅片	行业地区市场分析
一、亚洲半导体硅片	行业市场现状分析
二、2021-2025年亚洲半导体硅片	行业市场规模与需求分析
三、亚洲半导体硅片	行业市场前景分析
第四节 北美半导体硅片	行业地区市场分析
一、北美半导体硅片	行业市场现状分析
二、2021-2025年北美半导体硅片	行业市场规模与需求分析
三、北美半导体硅片	行业市场前景分析
第五节 欧洲半导体硅片	行业地区市场分析
一、欧洲半导体硅片	行业市场现状分析
二、2021-2025年欧洲半导体硅片	行业市场规模与需求分析
三、欧洲半导体硅片	行业市场前景分析
第六节 2026-2033年全球半导体硅片	行业分布走势预测
第七节 2026-2033年全球半导体硅片	行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国半导体硅片	行业运行情况
第一节 中国半导体硅片	行业发展介绍
一、半导体硅片行业发展特点分析	
二、半导体硅片行业技术现状与创新情况分析	
第二节 中国半导体硅片	行业市场规模分析
一、影响中国半导体硅片	行业市场规模的因素
二、2021-2025年中国半导体硅片	行业市场规模
三、中国半导体硅片行业市场规模数据解读	
第三节 中国半导体硅片	行业供应情况分析
一、2021-2025年中国半导体硅片	行业供应规模
二、中国半导体硅片	行业供应特点
第四节 中国半导体硅片	行业需求情况分析
一、2021-2025年中国半导体硅片	行业需求规模
二、中国半导体硅片	行业需求特点
第五节 中国半导体硅片	行业供需平衡分析

第六章 中国半导体硅片 行业经济指标与需求特点分析

第一节 中国半导体硅片 行业市场动态情况

第二节 半导体硅片 行业成本与价格分析

一、半导体硅片行业价格影响因素分析

二、半导体硅片行业成本结构分析

三、2021-2025年中国半导体硅片 行业价格现状分析

第三节 半导体硅片 行业盈利能力分析

一、半导体硅片 行业的盈利性分析

二、半导体硅片 行业附加值的提升空间分析

第四节 中国半导体硅片 行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第五节 中国半导体硅片 行业的经济周期分析

第七章 中国半导体硅片 行业产业链及细分市场分析

第一节 中国半导体硅片 行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、半导体硅片 行业产业链图解

第二节 中国半导体硅片 行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对半导体硅片 行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对半导体硅片 行业的影响分析

第三节 中国半导体硅片 行业细分市场分析

一、中国半导体硅片 行业细分市场结构划分

二、细分市场分析——市场1

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

(细分市场划分详情请咨询观研天下客服)

第八章 中国半导体硅片	行业市场竞争分析
第一节 中国半导体硅片	行业竞争现状分析
一、中国半导体硅片	行业竞争格局分析
二、中国半导体硅片	行业主要品牌分析
第二节 中国半导体硅片	行业集中度分析
一、中国半导体硅片	行业市场集中度影响因素分析
二、中国半导体硅片	行业市场集中度分析
第三节 中国半导体硅片	行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征	
二、企业规模分布特征	
三、企业所有制分布特征	
第四节 中国半导体硅片	行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理	
二、供应商议价能力	
三、购买者议价能力	
四、新进入者威胁	
五、替代品威胁	
六、同业竞争程度	
七、波特五力模型分析结论	
第九章 中国半导体硅片	行业所属行业运行数据监测
第一节 中国半导体硅片	行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析	
二、行业资产规模分析	
第二节 中国半导体硅片	行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产	
二、销售收入分析	
三、负债分析	
四、利润规模分析	
五、产值分析	
第三节 中国半导体硅片	行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析	
二、行业偿债能力分析	

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

- 第十章 中国半导体硅片 行业区域市场现状分析
- 第一节 中国半导体硅片 行业区域市场规模分析
 - 一、影响半导体硅片 行业区域市场分布的因素
 - 二、中国半导体硅片 行业区域市场分布
- 第二节 中国华东地区半导体硅片 行业市场分析
 - 一、华东地区概述
 - 二、华东地区经济环境分析
 - 三、华东地区半导体硅片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华东地区半导体硅片 行业市场规模
 - 2、华东地区半导体硅片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华东地区半导体硅片 行业市场规模预测
- 第三节 华中地区市场分析
 - 一、华中地区概述
 - 二、华中地区经济环境分析
 - 三、华中地区半导体硅片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华中地区半导体硅片 行业市场规模
 - 2、华中地区半导体硅片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华中地区半导体硅片 行业市场规模预测
- 第四节 华南地区市场分析
 - 一、华南地区概述
 - 二、华南地区经济环境分析
 - 三、华南地区半导体硅片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华南地区半导体硅片 行业市场规模
 - 2、华南地区半导体硅片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华南地区半导体硅片 行业市场规模预测
- 第五节 华北地区市场分析
 - 一、华北地区概述
 - 二、华北地区经济环境分析
 - 三、华北地区半导体硅片 行业市场分析
 - 1、2021-2025年华北地区半导体硅片 行业市场规模
 - 2、华北地区半导体硅片 行业市场现状
 - 3、2026-2033年华北地区半导体硅片 行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区半导体硅片 行业市场分析

1、2021-2025年东北地区半导体硅片 行业市场规模

2、东北地区半导体硅片 行业市场现状

3、2026-2033年东北地区半导体硅片 行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区半导体硅片 行业市场分析

1、2021-2025年西南地区半导体硅片 行业市场规模

2、西南地区半导体硅片 行业市场现状

3、2026-2033年西南地区半导体硅片 行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区半导体硅片 行业市场分析

1、2021-2025年西北地区半导体硅片 行业市场规模

2、西北地区半导体硅片 行业市场现状

3、2026-2033年西北地区半导体硅片 行业市场规模预测

第九节 2026-2033年中国半导体硅片 行业市场规模区域分布预测

第十一章 半导体硅片 行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国半导体硅片 行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体硅片 行业未来发展趋势预测

第二节 2026-2033年中国半导体硅片 行业投资增速预测

第三节 2026-2033年中国半导体硅片 行业规模与供需预测

一、2026-2033年中国半导体硅片 行业市场规模与增速预测

二、2026-2033年中国半导体硅片 行业产值规模与增速预测

三、2026-2033年中国半导体硅片 行业供需情况预测

第四节 2026-2033年中国半导体硅片 行业成本与价格预测

一、2026-2033年中国半导体硅片 行业成本走势预测

二、2026-2033年中国半导体硅片 行业价格走势预测

第五节 2026-2033年中国半导体硅片 行业盈利走势预测

第六节 2026-2033年中国半导体硅片 行业需求偏好预测

第十三章 中国半导体硅片 行业研究总结

第一节 观研天下中国半导体硅片 行业投资机会分析

一、未来半导体硅片 行业国内市场机会

二、未来半导体硅片行业海外市场机会

第二节 中国半导体硅片 行业生命周期分析

第三节 中国半导体硅片 行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国半导体硅片 行业SWOT分析结论

第四节 中国半导体硅片	行业进入壁垒与应对策略
第五节 中国半导体硅片	行业存在的问题与解决策略
第六节 观研天下中国半导体硅片	行业投资价值结论
第十四章 中国半导体硅片	行业风险及投资策略建议
第一节 中国半导体硅片	行业进入策略分析
一、目标客户群体	
二、细分市场选择	
三、区域市场的选择	
第二节 中国半导体硅片	行业风险分析
一、半导体硅片	行业宏观环境风险
二、半导体硅片	行业技术风险
三、半导体硅片	行业竞争风险
四、半导体硅片	行业其他风险
五、半导体硅片	行业风险应对策略
第三节 半导体硅片	行业品牌营销策略分析
一、半导体硅片	行业产品策略
二、半导体硅片	行业定价策略
三、半导体硅片	行业渠道策略
四、半导体硅片	行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议	

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202606/797626.html>